



平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成30年8月7日

東

上場会社名 アピックヤマダ株式会社

コード番号 6300 URL <http://www.apicyamada.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 押森広仁

問合せ先責任者 (役職名) 取締役企画部長 (氏名) 小出 篤 TEL 026-275-2111

四半期報告書提出予定日 平成30年8月10日 配当支払開始予定日 ー

四半期決算補足説明資料作成の有無：無

四半期決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 平成31年3月期第1四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年6月30日）

(1) 連結経営成績（累計） (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
31年3月期第1四半期	1,447	△23.8	△356	ー	△362	ー	△371	ー
30年3月期第1四半期	1,900	30.4	△248	ー	△251	ー	△418	ー

(注) 包括利益 31年3月期第1四半期 △419百万円 (ー%) 30年3月期第1四半期 △443百万円 (ー%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
31年3月期第1四半期	△29.92	ー
30年3月期第1四半期	△33.67	ー

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
31年3月期第1四半期	11,224	3,410	30.4
30年3月期	11,049	3,821	34.6

(参考) 自己資本 31年3月期第1四半期 3,410百万円 30年3月期 3,821百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
30年3月期	ー	0.00	ー	0.00	0.00
31年3月期	ー				
31年3月期(予想)		0.00	ー	0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 平成31年3月期の連結業績予想（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	5,600	19.2	△20	ー	△20	ー	△70	ー	△5.64
通期	12,600	△0.5	480	63.3	490	96.0	400	654.7	32.21

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無
新規 一社 （社名） 、除外 一社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	31年3月期1Q	12,969,000株	30年3月期	12,969,000株
② 期末自己株式数	31年3月期1Q	549,574株	30年3月期	549,573株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	31年3月期1Q	12,419,426株	30年3月期1Q	12,419,427株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手できる情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績の予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P. 2「1. 当四半期に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報等)	8
(参考資料)	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計年度との比較・分析を行っております。

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間（平成30年4月1日～平成30年6月30日）における世界経済は、米国の大型減税、中国を中心としたアジアでの設備投資需要が牽引し、景気の拡大が続いています。一方、我が国の経済は、企業収益及び雇用環境が改善傾向となり、個人消費の持ち直しが見られるとともに、設備投資が増加基調で推移するなど、穏やかな景気回復基調で推移しました。しかしながら中国との貿易戦争に突入した米国発の通商摩擦や、急速な原油高、米国の利上げなど景気の不確実性を高めるリスクが増大しています。

こうした環境の中で、当社グループの主な供給先である半導体業界においては、半導体需要は依然として旺盛であることから、半導体製造装置需要が今後も伸びることが見込まれております。特に中国においては、半導体国産化政策の影響もあり半導体メーカーの設備投資が活発化しております。また、自動車業界に関しては、自動車の高機能化による電子制御装置の増加や、電気自動車・ハイブリッド自動車の増加により、車載用センサー、インバーターなどの車載用半導体需要の拡大が継続しております。

当社においては、スマートフォンの成長鈍化によるスマートフォン向け半導体の設備投資判断の遅延の影響はあるものの、WLP（ウェハーレベルパッケージ）用コンプレッションモールド装置はスーパーコンピューター・サーバー用CPUやメモリー向けの引合い、受注の動きが活発化しております。また、車載向け半導体製造装置は、センサーやインバーター等の増産の動きの中で、受注は引き続き好調に推移いたしました。しかしながら、装置用部品の一部において、調達期間の長期化が解消しないことから納期への影響が発生し、売上に影響いたしました。

この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は1,447百万円（前年同四半期比23.8%減）、営業損失は356百万円（前年同四半期は営業損失248百万円）、経常損失は362百万円（前年同四半期は経常損失251百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は371百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失418百万円）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

①電子部品組立装置

電子部品組立装置の受注環境は、車載向け装置は車載用センサーやインバーター等の車載用半導体の需要拡大とともに国内外とも引続き順調な動きとなっております。一方、WLP（ウェハーレベルパッケージ）用コンプレッションモールド装置は中国からの受注が動き出すとともに、従前の高機能向けスマートフォンのパッケージ向け用途中心から、スーパーコンピューター・サーバー向け、メモリー向け等その用途が拡大し、前年同期と比べ受注が増加しております。また、景気の回復とともに装置に使用する部材の調達が長期化していること等により、納期及び売上の遅延が発生し、売上の構成も利益率の高い高額製品の売上が低かったことから、売上及び利益は当初想定を下回りました。

この結果、売上高は1,071百万円（前年同四半期比29.5%減）、セグメント損失は199百万円（前年同四半期はセグメント損失91百万円）となりました。

②電子部品

車載向け製品が好調に推移したこと、LPS（LEDプリモールド基板）事業の人員を含む生産体制の大幅な縮小及び電子部品を製造していたタイ子会社の閉鎖により、赤字幅は大幅に縮小いたしました。

この結果、売上高は288百万円（前年同四半期比1.3%減）、セグメント損失は6百万円（前年同四半期はセグメント損失18百万円）となりました。

③その他

その他につきましては、リード加工金型及びリードフレーム用生産金型の販売であります。リードフレームを使用する半導体の設備投資につきましてはマーケットが限られておりますが、車載向けの受注が好調に推移しました。

この結果、売上高は87百万円（前年同四半期比1.3%減）、セグメント利益は6百万円（前年同四半期比37.2%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、11,224百万円（前連結会計年度末は11,049百万円）となり、前連結会計年度末と比較して174百万円増加いたしました。これは主に、棚卸資産の増加によるものであります。

(負債)

当第1四半期連結会計期間末における負債合計は、7,814百万円（前連結会計年度末は7,228百万円）となり、前連結会計年度末と比較して585百万円増加いたしました。これは主に、短期借入金及び買掛金の増加によるものであります。

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は、3,410百万円（前連結会計年度末は3,821百万円）となり、前連結会計年度末と比較して410百万円減少いたしました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上による利益剰余金の減少によるものであります。

なお、これらの要因により、自己資本比率は30.4%（前連結会計年度末は34.6%）となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成30年5月14日の「平成30年3月期 決算短信」で公表いたしました第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,197,497	1,950,113
受取手形及び売掛金	2,918,434	2,143,340
商品及び製品	321,363	811,575
仕掛品	2,242,932	2,806,959
原材料及び貯蔵品	419,689	499,019
その他	68,975	145,514
貸倒引当金	△7,041	△6,914
流動資産合計	8,161,851	8,349,608
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	740,725	722,416
機械装置及び運搬具(純額)	361,776	364,134
土地	484,534	484,534
その他	223,075	258,218
有形固定資産合計	1,810,112	1,829,304
無形固定資産	111,459	106,359
投資その他の資産		
その他	969,888	942,878
貸倒引当金	△3,350	△3,350
投資その他の資産合計	966,538	939,528
固定資産合計	2,888,110	2,875,193
資産合計	11,049,962	11,224,801
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,767,880	2,075,983
短期借入金	3,016,000	3,360,000
1年内返済予定の長期借入金	159,600	159,600
未払法人税等	63,303	13,095
賞与引当金	124,571	67,309
製品保証引当金	70,008	68,212
その他	638,713	743,806
流動負債合計	5,840,077	6,488,007
固定負債		
長期借入金	477,500	437,600
退職給付に係る負債	680,740	673,732
その他	230,105	214,921
固定負債合計	1,388,345	1,326,254
負債合計	7,228,422	7,814,261

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成30年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,837,500	5,837,500
利益剰余金	△1,688,138	△2,059,707
自己株式	△101,247	△101,248
株主資本合計	4,048,113	3,676,544
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	25,131	11,587
為替換算調整勘定	△252,752	△278,528
退職給付に係る調整累計額	1,046	937
その他の包括利益累計額合計	△226,573	△266,004
純資産合計	3,821,539	3,410,540
負債純資産合計	11,049,962	11,224,801

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年6月30日)
売上高	1,900,061	1,447,407
売上原価	1,579,387	1,214,787
売上総利益	320,673	232,620
販売費及び一般管理費	568,951	589,528
営業損失(△)	△248,277	△356,907
営業外収益		
受取利息及び配当金	1,434	1,323
為替差益	691	6,716
受取技術料	6,842	—
受取賃貸料	3,266	3,269
その他	6,214	5,929
営業外収益合計	18,450	17,238
営業外費用		
支払利息	17,699	18,469
持分法による投資損失	2,442	2,925
その他	1,185	1,302
営業外費用合計	21,327	22,697
経常損失(△)	△251,155	△362,366
特別利益		
固定資産売却益	5,601	69
特別利益合計	5,601	69
特別損失		
過年度決算訂正関連費用	158,343	—
特別損失合計	158,343	—
税金等調整前四半期純損失(△)	△403,897	△362,296
法人税、住民税及び事業税	5,246	4,916
法人税等調整額	9,058	4,356
法人税等合計	14,305	9,272
四半期純損失(△)	△418,202	△371,568
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△418,202	△371,568

(四半期連結包括利益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)
四半期純損失(△)	△418,202	△371,568
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	8,115	△13,544
為替換算調整勘定	△21,442	△22,188
退職給付に係る調整額	3,572	△109
持分法適用会社に対する持分相当額	△15,812	△12,097
その他の包括利益合計	△25,567	△47,940
四半期包括利益	△443,770	△419,509
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△443,770	△419,509

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			合計
	電子部品 組立装置	電子部品	その他 (注)	
売上高				
外部顧客への売上高	1,518,976	292,765	88,319	1,900,061
セグメント間の内部売上高又は振替高	9	748	461	1,219
計	1,518,985	293,514	88,780	1,901,280
セグメント利益又は損失(△)	△91,743	△18,606	4,404	△105,945

(注)「その他」の区分は、リード加工金型及びリードフレーム生産用金型の調達・販売等を行っております。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び該当差額の主要な内容(差額調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	△105,945
セグメント間取引高消去	—
全社費用(注)	△142,332
四半期連結損益計算書の営業損失(△)	△248,277

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。

II 当第1四半期連結累計期間(自平成30年4月1日 至平成30年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位: 千円)

	報告セグメント			合計
	電子部品 組立装置	電子部品	その他 (注)	
売上高				
外部顧客への売上高	1,071,310	288,913	87,184	1,447,407
セグメント間の内部売上高又は振替高	181	1,557	16,218	17,957
計	1,071,491	290,470	103,402	1,465,365
セグメント利益又は損失(△)	△199,132	△6,143	6,043	△199,233

(注) 「その他」の区分は、リード加工金型及びリードフレーム生産用金型の調達・販売等を行っております。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び該差額の主要な内容(差額調整に関する事項)

(単位: 千円)

利益	金額
報告セグメント計	△199,233
セグメント間取引高消去	—
全社費用(注)	△157,674
四半期連結損益計算書の営業損失(△)	△356,907

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。

(参考資料)

受注及び販売の状況

当第1四半期連結累計期間(自平成30年4月1日至平成30年6月30日)の受注及び販売の実績は次のとおりです。

(1)受注実績

セグメントの名称	受注高(千円)	構成比(%)	前年同期比(%)
電子部品組立装置	2,906,278	84.2	162.3
電子部品	328,573	9.5	104.9
その他	215,718	6.3	191.8
合計	3,450,570	100.0	155.7

(2)受注残実績

セグメントの名称	受注残高(千円)	構成比(%)	前年同期比(%)
電子部品組立装置	5,426,530	92.1	82.7
電子部品	170,370	2.9	126.5
その他	293,718	5.0	184.1
合計	5,890,618	100.0	85.9

(注) 当第1四半期連結期間の末日の受注残高

(3)販売実績

セグメントの名称	販売高(千円)	構成比(%)	前年同期比(%)
電子部品組立装置	1,071,310	74.0	70.5
電子部品	288,913	20.0	98.7
その他	87,184	6.0	98.7
合計	1,447,407	100.0	76.2